# C 含量对电弧离子镀 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> (x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69)薄膜性能的影响

# 杨立军<sup>1</sup>,张泽辉<sup>1</sup>,李 林<sup>2</sup>,张 勇<sup>1</sup>

(1. 陕西科技大学,陕西西安 710021)(2. 咸阳恒信纺机器材有限公司,陕西咸阳 710020)

**摘 要:**在 GCr15 轴承钢基体上,利用多弧离子镀技术低温(175 ℃)沉积 TiAICN 涂层。利用 SEM、EPMA、XRD、 附着力测试仪、纳米压痕仪和 UMT-2 高温摩擦磨损测试仪研究薄膜性质。结果表明,涂层表面光滑平整、均匀致密且 无明显孔洞。涂层表面存在一定数量的液滴颗粒,薄膜厚度约为 2 µm。在涂层中,发现了晶体结构为 fcc-TiN 结构, 薄膜的晶粒大小为 10~30 nm;随着薄膜中 C 元素的加入,XRD 谱中(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N 峰出现了宽化;在 TiAIN 中引入 C, 附着力下降,随着涂层中 C 含量的增加,薄膜中的 Al 和 Ti 比例未发生明显变化,附着力略微增加,但硬度和弹性模 量先增加后减小,摩擦系数一直减小。

关键词:电弧离子镀; TiAlCN; 附着力; 摩擦系数; 硬度 中图法分类号: TG174.444 文献标识码: A

物理气相沉积技术已经在航空、航天、刀具等领域 都有具体应用。TiAIN 是在 TiN 上发展的一种膜, TiAIN 作为典型的硬质薄膜材料已经广泛应用于工业领域。 TiAIN 薄膜不仅硬度高、耐磨性能好,而且抗氧化性能 好,抗氧化温度超过 800 ℃<sup>[1]</sup>。由于 AI 的加入形成了 单相亚稳态(Ti,A1)N<sup>[2-4]</sup>,从而显著地提高了薄膜的力 学性能,TiAIN 涂层经 550 和 700 ℃氧化后,膜层仍 保持光亮完整状态,对 TC4 钛合金仍具有非常好的防 护效果,明显改善了 TC4 钛合金的高温抗氧化性能<sup>[5]</sup>。 另一方面,TiCN 薄膜硬度高于 TiC 和 TiN<sup>[6]</sup>,且 TiCN 有较好的耐磨性和低的摩擦系数,但高于 400 ℃ 时薄 膜失效<sup>[7]</sup>,钢丝圈在钢领表面高速滑动时,表面温度达 到 400 ℃,因此钢领上不适合镀此薄膜。

由于 TiAICN 薄膜不仅具有优异的抗氧化性能,而 且具有 TiCN 薄膜良好的机械性能<sup>[8]</sup>,因此人们尝试研 究 TiAICN 薄膜。直到现在,TiAICN 薄膜的研究仍然 比较少。本实验主要研究 C 含量对薄膜附着力、硬度、 弹性模量和摩擦系数的影响。

# 1 实 验

试验基材选用 GCr15 钢领。镀膜前,基体材料用 无水乙醇清洗。TiAlCN 薄膜在 HY9940-1B 多弧离子 镀膜机(清华大学)上进行,试验采用 50:50 的铝钛 文章编号: 1002-185X(2015)06-1455-04

(原子分数比)合金靶。轰击清洗基体之前,抽真空 至 6×10<sup>-3</sup>~9.9×10<sup>-3</sup>Pa。轰击偏压 500~700 V,轰击 时间 5 min。表 1 为薄膜的沉积工艺参数,其中弧电 流为 50 A,负偏压为–100 V,沉积温度为 175 ℃,镀 膜时间 45 min,工作气压为(4~5)×10<sup>-1</sup>Pa。

日立S-4800扫描电镜观察表面形貌、测量薄膜厚 度;日立S-4800扫描电镜附带的电子探针(EPMA)测 定薄膜的成分;日本理学D/max2000PC X射线衍射仪 确定薄膜的相组成和结构;附着力采用WS2005薄膜附 着力自动划痕仪进行测试,试验载荷100 N,加载速率 100 N/min,划痕长度5 mm,划痕速率5 mm/min,声 发射信号接收。为了避免基体对薄膜硬度有影响,所 制备的薄膜厚度大于2 μm,并且纳米压痕仪 (Nano-indenter-XP型)测试时的压入深度不超过薄膜 厚度的1/10,所用的加载力为10 mN。加载速度为20 mN/min,保载时间为10 s,每个样品采5个点测定硬度 并取平均值。采用美国CETR 公司生产的UMT-2 高温 摩擦磨损测试仪测试材料的摩擦磨损,摩擦副为高碳 钢磨球,摩擦对偶副的粗糙度*Ra*: 0.01~0.02 μm,载 荷为2 N,转速: 200 r/min,摩擦时间为30 min。

# 2 结果与讨论

## 2.1 薄膜形貌和厚度

收稿日期: 2014-06-12

基金项目: 陕西省教育厅产业化中试项目资助 (2011TG24)

作者简介:杨立军,男,1974年生,博士,教授,陕西科技大学机电工程学院,陕西西安 710021, E-mail: 595745260@qq.com

图1a、1b、1c、1d分别为试样1、2、4、5的表 面形貌。从图中可以看出涂层表面光滑平整、均匀 致密且无明显孔洞。涂层表面存在一定数量的液滴 颗粒,颗粒尺寸小于2 μm。颗粒产生的原因是由低 熔点的Al在电弧蒸发过程中产生的,金属离子快速 蒸发时产生大量的原子,而这些原子在到达基体之 前不能完全电离,未电离的中性原子就会在飞行过 程中结合成大的颗粒。图1e为试样4的断面形貌,薄 膜的厚度约为2 μm。

## 2.2 薄膜的相组织和成分

图2是TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>(x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69)随着C含 量变化的XRD图谱。从图2中可以看出,沉积完成时 的TiAlCN薄膜的晶体结构为fcc-TiN结构,TiN 晶体结 构为类似NaCl面心立方结构,TiN与(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N的晶 体结构相近,晶格常数相近, XRD 谱线无法分辨<sup>[9]</sup>, 故仅以TiN的衍射峰表现出来。对XRD 图谱进行 Pseudo-Voigt 函数拟合得到(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N薄膜的平均 晶粒大小为10~30 nm。随着薄膜中C元素的加入, XRD 谱中(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N峰出现了宽化,应该是晶粒尺寸减小 所致,也可能是薄膜中残余应力的积累引起的<sup>[10]</sup>。不 通入乙炔气体时,薄膜的涂层没有Ti(C<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub>)峰和 AlFe<sub>3</sub>C<sub>0.5</sub>峰,并且(Ti,Al)N (311)峰不明显。位于36.6°, 42.5°, 61.9°, 74.3°附近的峰分别为(Ti<sub>0.5</sub>, Al<sub>0.5</sub>) N (111)、(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N(200)、(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N(220) 和 (Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N (311) 峰,并且所有的涂层都具有 (111)、(200)、(220)和(311)的(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N晶面。 随着碳含量的增加, (Ti<sub>0.5</sub>, Al<sub>0.5</sub>) N (311)的峰的强度 减弱。另外,涂层中可能有AlFe<sub>3</sub>C<sub>0.5</sub>和Fe<sub>0.975</sub>Ti<sub>0.025</sub>固 溶体,这是由于在离子轰击清洗和打底时,高能量 的铝离子和钛离子在高负偏压作用下轰击GCr15轴 承钢表面, 使基体表面温度升高, 铝离子和钛离子 渗透到基体中形成Fe0.975Ti0.025和AlFe3C0.5的固溶 体,提高膜/基附着力,基体表面温度越高,离子渗 透的也就越容易。

表 2 是 EPMA 测定的 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> 薄膜表面面扫描 化学成分。从表 2 中可以看出,当 C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>流量从 0 增加 到 150 mL/min,涂层中 C 元素含量从 0%增加到 44.74%;当 N<sub>2</sub>流量从 200 减小到 50 mL/min,涂层中 N 元素含量从 58.60%减小到 20.02%。靶材中 Ti 和 AI 比例为 1:1,随气体流量变化,薄膜中 Ti 和 AI 比例约 为 1:1, Ti 和 AI 比例未发生明显变化。

## 2.3 C含量对附着力的影响

表3是不同碳含量的TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>薄膜的附着力。随着C元素的加入,薄膜的附着力明显减小,这可能是由于C元素的加入导致晶格畸变,从而导致薄膜内

表1 沉积工艺参数

Table 1	Deposition	conditions
---------	------------	------------

Sample No.	N/mL min <sup>-1</sup>	$C_2H_2/\ mL\ min^{-1}$		
1	200	0		
2	150	50		
3	100	100		
4	80	120		
5	50	150		





Fig.1 Surface morphologies of TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> films with various C contents: (a) x=0, (b) x=0.18, (c) x=0.49, (d) x=0.69, and (e) cross-section of x=0.49 sample



- 图 2 不同 C 含量的 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>(x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69)薄膜的 XRD 图谱
- Fig.2 XRD patterns of TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> (x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69) film with various C contents

应力增加。当薄膜中 C 含量从 0.18 增加到 0.69 时, 附着力略有增加,发生这种现象的原因可能是随着薄 膜中 C 含量的增加,薄膜中非晶碳含量也增加,非晶

#### 表 2 EPMA 测定的薄膜表面面扫描化学成分

 Table 2
 Chemical composition on the surface of films by

	()			
Sample	С	Ν	Al	Ti
1	0	58.60	22.40	19.00
2	11.82	53.83	17.89	16.46
3	26.44	38.05	17.95	17.56
4	31.55	33.10	18.06	17.29
5	44.74	20.02	18.75	16.49

碳抑制了薄膜中晶粒的生长,从而起到细化晶粒的作用,非晶碳含量的增加和晶粒尺寸减小到一定尺寸后, 更有利于释放薄膜内部的残余应力,于是附着力增加; 另外,TiAlC<sub>0.69</sub>N<sub>0.31</sub>薄膜的硬度较低,与基体硬度差 异小,从而强化了膜基结合力,因此,试样 5 附着力 高于试样 3 和 4。

## 2.4 C含量对硬度的影响

图3为 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>薄膜的硬度和弹性模量随 C 含量 的变化曲线。可以看出,随着 C 含量的变化,硬度和 弹性模量变化趋势相似。没有 C 时,薄膜硬度为10.214 GPa, 弹性模量为188.996 GPa; 当在 TiAlN 薄膜中添 加C后,与TiAIN薄膜相比,TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>薄膜的硬度和 弹性模量明显增加;当C含量从0增加到0.18时,硬度 和弹性模量增加的稍微缓慢; 当 C 含量从0.18增加到 0.49时,硬度和弹性模量急剧增加,当C含量为0.49时, 硬度和弹性模量分别达到最大值26.217和467.205 GPa, 硬度随着 C 含量的增加而增加可以解释为薄膜中的 C 元素取代 N 元素引起了晶格畸变和共价键的增加,而 共价键的增加是由于 C 原子的化合价比 N 的少1个,从 而使得薄膜的硬度得到显著的提高<sup>[11]</sup>;随着 C 含量的 进一步增加,薄膜的硬度和弹性模量都有明显的下降趋 势,原因可能是晶粒尺寸小,晶界滑移的可能性增加, 薄膜的硬度随着晶界滑移而下降。研究表明,多元素 化合往往形成多相混合结构, 第二相的存在能够提高 机械性能,提高 Hall-Petch<sup>[12-14]</sup> 强化效应和裂纹捕获、 偏移能力,进而提高了薄膜的强度和硬度。

文献中[15-17]普遍认为可以通过 *H/E*(或*H<sup>3</sup>/E<sup>2</sup>*)的值来预测衡量薄膜的耐磨性能,称之为"抗塑性变形抗力"。即可以通过已获得的薄膜的硬度和弹性模量来 推测衡量薄膜的摩擦磨损等其他方面的性能。通过这 些硬度和弹性模量值可以求出 *H<sup>3</sup>/E<sup>2</sup>*值。*H<sup>3</sup>/E<sup>2</sup>*越大, 说明材料的抗塑性变形抗力越强。随着 C 含量的增加, H<sup>3</sup>/E<sup>2</sup>值先增加后减小。TiAlC<sub>0.41</sub>N<sub>0.59</sub>薄膜的 *H<sup>3</sup>/E<sup>2</sup>*值 最大,达到 0.124,说明该薄膜的抗塑性变形抗力最好。

## 2.5 C含量对摩擦系数的影响

图 4 为不同 C 含量时 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> 薄膜的摩擦系数。 当 N<sub>2</sub> 流量为 150 mL/min, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> 流量为 50 mL/min 时,



表 3 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>薄膜的附着力

图 3 不同 C 含量的 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>(x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69)薄膜的 硬度和弹性模量

Fig.3 Hardness and elastic modulus of TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> (x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69) film as functions of C contents



图 4 不同 C 含量的 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>(x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69)薄膜的 摩擦系数

Fig.4 Friction coefficient of  $TiAlC_xN_{1-x}$  (x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69) as a function of C content

摩擦系数超过 0.5; 当  $N_2$ 流量为 100 mL/min,  $C_2H_2$  流 量为 100 mL/min, 薄膜摩擦系数约为 0.3; 当  $N_2$ 流量为 50 mL/min,  $C_2H_2$  流量为 50 mL/min 时, 摩擦系数约为 0.21。薄膜中 C 元素的加入,降低了摩擦系数。乙炔流 量从 50 mL/min 增加到 100 mL/min,摩擦系数急剧减 小,进一步增加  $C_2H_2$ 流量,摩擦系数减小缓慢。研究表 明,钢领摩擦系数一般在 0.1~0.3<sup>[18]</sup>之间,虽然  $N_2$ 流量 为 100 mL/min,  $C_2H_2$  流量为 100 mL/min,薄膜的抗塑 性变形抗力最好,但是摩擦系数偏大,在  $N_2$ 流量为 50 mL/min, $C_2H_2$  流量为 50 mL/min 时,摩擦系数约为 0.21 最小,但是薄膜的硬度和弹性模量均较小,因此在实际 生产中,N<sub>2</sub>流量控制在 80 mL/min,C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> 流量为 120 mL/min,薄膜具有较高的硬度和较低的摩擦系数。薄膜 中 C 含量的增加,摩擦系数减小,这是由于 C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> 气体 含量的增加会使得涂层中非晶碳增加,钢球在涂层表面 滑动,起到润滑的作用<sup>[19]</sup>。

# 3 结 论

1) 采用电弧离子镀技术在 GCr15 轴承钢基体上沉积 TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub>(x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69)薄膜, 涂层表面存在一 定数量的液滴颗粒, 颗粒尺寸小于2 μm。薄膜厚度约2 μm。 薄膜主要相组成是(Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N、AlFe<sub>3</sub>C<sub>0.5</sub>和 Fe<sub>0.975</sub> Ti<sub>0.025</sub>。

2) 随着薄膜中 C 元素的加入, XRD 谱中 (Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N 峰出现了宽化,薄膜的平均晶粒大小为 10~30 nm。薄膜中 C 含量从 0 增加到 0.69,薄膜的 Ti 和 Al 比例约为 1:1, Ti 和 Al 比例未发生明显变化。

3) 当在薄膜中引入 C 元素,薄膜硬度增加,附着力 减小。随着薄膜中 C 含量的增加,附着力从 29 N 增加 到 33 N,薄膜硬度和弹性模量先增加后减小,薄膜最大 硬度和弹性模量分别为 26.217 和 467.205 GPa,摩擦系 数呈现明显的下降趋势。

### 参考文献 References

- Kawate M, Kimura Hashimoto A, Suzuki T. Surface and Coatings Technology [J], 2003, 165(2): 163
- [2] Von Riehthofen A, Cremer R, Witthau M et al. Thin Solid Films[J], 1998, 312(1): 190
- [3] Wuther R, Yeung W Y, Phillips M R et al. Thin Solid Films[J], 1996, 290: 339
- [4] Kester D J, Messier R. Journal of Materials Research[J], 1993, 8(8): 1928

- [5] Pan Xiaolong (潘晓龙), Wang Shaopeng (王少鹏), Li Zhengxian(李争显) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀 有金属材料与工程) [J], 2008, 37(S4): 598
- [6] Zhang G, Li B, Jiang B et al. Applied Surface Science[J], 2009, 255(21): 8788
- [7] Li Chen, Wang S Q, Zhou S Z et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials [J], 2008, 26(5): 456
- [8] Knotek O, Löffler F, Wolkers L. Surface and Coatings Technology[J], 1994, 68: 176
- [9] Yamamoto R, Takeda Y, Yokoyama H et al. Journal of the Japan Institute of Metals[J], 2004, 68(10): 908
- [10] Pfeiler M, Kutschej K, Penoy M et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2009, 27(2): 502
- [11] Jang C S, Jeon J H, Song P K et al. Surface and Coatings Technology[J], 2005, 200(5): 1501
- [12] Shi Jin(时 婧), Pei Zhiliang (裴志亮), Gong Jun(宫 骏) et al. Acta Metallurgica Sinica (金属学报)[J], 2012, 48(11): 1349
- [13] Petch N J. The Journal of the Iron and Steel Institute[J], 1953, 174: 25
- [14] Hall E O. Proceedings of the Physical Society, London, Section B [J] 1951, 64: 747
- [15] Tam P L, Zhou Z F, Shum P W et al. Thin Solid Films[J], 2008, 516(16): 5725
- [16] Matthews A, Franklin S, Holmberg K. Journal of Physics D: Applied Physics [J], 2007, 40(18): 5463
- [17] Musil J, Jirout M. Surface and Coatings Technology[J], 2007, 201(9): 5148
- [18] Zhang Yiming(张一鸣), Cui Weigang (崔卫纲), Guo Weifen (郭维芬). Textile Accessories(纺织器材) [J], 2007, 34(4): 1
- [19] Lackner J M, Waldhauser W, Ebner R. Surface and Coatings Technology [J], 2004, 188: 519

# Effect of C Content on Properties of TiAlC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> (x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69) Films Deposited by Arc Ion Plating

Yang Lijun<sup>1</sup>, Zhang Zehui<sup>1</sup>, Li Lin<sup>2</sup>, Zhang Yong<sup>1</sup>

(1. Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

(2. Xianyang HengXin Textile Machinery Co., Ltd, Xianyang 710020, China)

**Abstract:** The composite TiAlCN films were deposited by vacuum arc ion plating on GCr15 rings at 175 °C. The properties of the films were characterized by SEM, EPMA, XRD, adhesion tester, nano-hardness tester and UMT-2 high temperature tribometer. The results indicate that the surface of the films is smooth and dense without any obvious pores. There are a certain number of droplets on the surface of films. The thickness of the films is about 2  $\mu$ m. The fcc structure of TiN is found in the films. The grain size of the films is from 10 to 30 nm. With the addition of C element into the film, (Ti<sub>0.5</sub>,Al<sub>0.5</sub>)N peak in XRD patterns appears in width. After adding C into TiAlN, the adhesion of the films declines. However, the adhesion increases slightly along with the increase of the C content, but Al and Ti ratio does not change significantly. Besides, the hardness and elastic modulus increase first and then decreases, and the friction coefficient is always declined.

Key words: vacuum arc ion plating; TiAlCN films; adhesion; friction coefficient; hardness

Corresponding author: Yang Lijun, Ph. D., Professor, College of Mechanical & Electrical Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, P. R. China, E-mail: 595745260@qq.com